

深圳天德钰科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：合肥捷达微电子有限公司（以下简称“合肥捷达”），系深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天德钰”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合肥捷达提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过生效后生效。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“合肥晶合”）的客户，向合肥晶合购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等。为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，董事会同意公司为合肥捷达提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度。担保期限为自公司第二届董事会第七次会议批准且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司在上述担保额度范围内承担连带保证责任。目前公司尚未签署担保协议，具体内容以实际与合肥晶合签署的担保协议为准，公司与合肥晶合不存在关联关系。

二、被担保人基本情况

合肥捷达微电子有限公司

公司名称	合肥捷达微电子有限公司	注册资本	5000 万元
法定代表人	郭英麟	股权结构	天德钰持股 100%
成立日期	2017 年 7 月 11 日		
注册地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内淝河路与项王路交口 3 号标准厂房一楼		
经营范围	集成电路模块及电子产品软硬件的技术开发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让； 电子产品、电子设备、机械设备的设计、开发、销售；佣金代理（除拍卖）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

主要财务数据：

财务情况	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	124,185,254.95	136,379,118.83
负债总额	26,529,039.81	39,012,619.17
资产净额	97,656,215.14	97,366,499.66
营业收入	75,377,288.30	217,537,545.79
净利润	126,262.91	8,177,715.47
扣除非经常性损益后的净利润	-402,284.04	7,405,348.39

注 1：截止本公告日，合肥捷达不存在被列为失信被执行人的情况，不存在影响被担保人偿债能力的重大事项。

注 2：2023 年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

合肥捷达向供应商合肥晶合购买集成电路制造相关服务，公司同意当合肥捷达延迟或无法履行上述事项的付款义务时，承担不超过人民币 5,000 万元的连

带保证责任。担保期限为自公司第二届董事会第七次会议批准后且担保函签署之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，公司尚未签署担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。公司与合肥晶合无关联关系。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该担保对象为公司全资子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及全资子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为0元（不含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的0%，占公司最近一期经审计总资产的0%；公司无逾期对外担保。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年8月24日